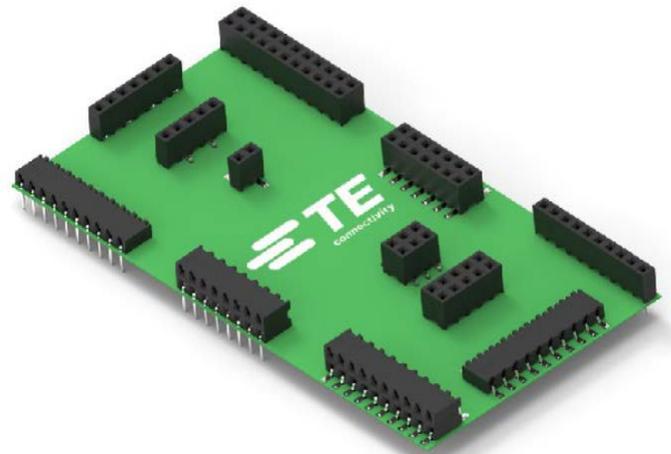


新製品

AMPMODU 2mm 基板対基板 リセプタクル

- ・ 本リセプタクルコネクタはデュアルビームコンタクトを採用しており、ヘッダーピンとの嵌合の際、高い接触信頼性を示し、安心してお使いいただけます。
- ・ 既存の2.54mm ピッチタイプと比較して実装時の占有面積を38%削減することで、他部品を実装する実装面積が広がっています。



AMPMODU 2 mm 基板対基板リセプタクルは、デュアルカンチレバービームを備えたリン青銅コンタクトを使用し、金めっきと錫めっきのオプションを用意しています。デュアルビームコンタクトにより、ヘッダーピンとリセプタクルコンタクトの接触信頼性の高い信号伝送を実現しました。高耐熱性樹脂製ハウジングのリセプタクルは、リフロー実装、スルーホールリフロー（ピンインペースト）、および従来のディッピング工程に適用できます。本製品シリーズは豊富な製品ラインナップを取り揃えており、トップおよびデュアルエン트리型、垂直・水平取付型など様々な嵌合タイプが用意されており、ヘッダーとリセプタクルの多様な組合せの基板対基板実装をお客様のご用途に合わせ提供できます。

主な特徴

- ・ ピッチ: 2.00mm
- ・ デュアルビームリセプタクルコンタクト
- ・ トップおよびデュアルエン트리型垂直および水平取付型リセプタクルアセンブリ
- ・ 基板の厚さ、1.6mmから2.4mmに対応するため、様々な半田付け部の長さが用意されており、サーフェスマウントとスルーホール実装に対応可能
- ・ 高耐熱、熱可塑性樹脂ハウジング
- ・ 梱包: チューブ、エンボスパッケージング
- ・ 1列当たり25極まであり、1列と2列タイプ有り
- ・ 環境対応: UL94V0、ハロゲンフリー/低ハロゲン

機械的特性

- ・ 動作温度:
 - 40 ~ 105°C (錫めっき部分)
 - 40 ~ 125°C (金めっき部分)
- ・ 振動: 振動中1マイクロ秒を超える不連続導通を生じない
- ・ リフローはんだ: 260°Cまで可能

材料

- ・ コンタクト部: 0.76 μm金 0.38 μm金 0.1 μm金
- ・ コンタクト材料: リン青銅
- ・ ハウジング材料: 高耐熱、熱可塑性樹脂、UL 94V0、黒

電気的特性

- ・ 電流定格: 2 A(最大)
- ・ 耐電圧: 650 VAC
- ・ 動作電圧: 125Vrms(最大)

詳細

[AMPMODU 2mm Board-to-Board Receptacles Flyer](#)
[AMPMODU 2mm Board-to-Board Receptacles Part List](#)
[AMPMODU 2mm Connectors Product Page](#) [AMPMODU 2mm Connectors Training Slides](#)

TE Connectivity, TE および TE connectivity (ロゴ) は商標です。